

证券代码：002916

证券简称：深南电路

### 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-04

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
活动参与人员（排名不分先后）	信达澳亚、长江养老保险、国金证券、华泰证券
上市公司接待人员	副总经理、董事会秘书：张丽君；投资者关系经理：郭家旭
时间	2025年1月15日
地点	公司会议室
形式	实地调研
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>交流主要内容：</b></p> <p><b>Q1、请介绍公司 PCB 业务主要产品下游应用分布情况。</b></p> <p>公司在 PCB 业务方面从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心（覆盖无线侧及有线侧通信），重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子（聚焦新能源和 ADAS 方向）等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。</p> <p><b>Q2、请介绍公司 2024 年第三季度 PCB 业务各下游领域经营拓展情况。</b></p> <p>2024 年第三季度，受通用服务器需求及国内汽车电子产品需求增长影响，公司 PCB 业务营收在数据中心及汽车电子领域环比二季度有所提升，通信领域受无线侧通信基站相关产品需求无明显改善影响，营收占比有所下降。</p> <p><b>Q3、介绍 AI 领域的发展对公司 PCB 业务产生的影响。</b></p> <p>伴随 AI 技术的加速演进和应用上的不断深化，新一代信息技术产业对于高算力和高速</p>

网络的需求日益迫切，驱动了行业对于大尺寸、高层数、高频高速、高阶 HDI、高散热等 PCB 产品需求的提升。公司 PCB 业务在高速通信网络、数据中心交换机、AI 加速卡、存储器等领域的 PCB 产品需求均受到上述趋势的影响。

**Q4、请介绍公司是否具备 HDI 工艺技术能力。**

HDI 作为一项平台型工艺技术，可实现 PCB 板件的高密度布线。公司 PCB 业务具备 HDI 工艺能力，主要应用于通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等下游领域的部分中高端产品。

**Q5、请介绍公司 PCB 业务有无进一步扩产的空间。**

公司 PCB 业务在深圳、无锡、南通及泰国项目（在建）均设有工厂。一方面，公司可通过对现有成熟 PCB 工厂进行持续的技术改造和升级，增进生产效率，释放一定产能；另一方面，公司在南通基地尚有土地储备，具备新厂房建设条件，南通四期项目已有序推进基建工程，拟建设为具备覆盖 HDI 等能力的 PCB 工艺技术平台。公司将结合自身经营规划与市场需求情况，合理配置业务产能。

**Q6、请介绍公司在封装基板领域的产品布局情况。**

公司封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。公司目前已具备包括 WB、FC 封装形式全覆盖的 BT 类封装基板量产能力。另一方面，针对 FC-BGA 封装基板产品，公司通过近年来持续的技术研发工作，已实现部分产品的技术能力突破，相关客户认证及产能建设工作取得进展。目前，公司已成为内资最大的封装基板供应商。

**Q7、请介绍广州封装基板项目连线爬坡进展。**

公司广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力在今年持续快速提升，已承接部分产品订单。目前其产能爬坡尚处于前期阶段，重点仍聚焦平台能力建设，推进客户各阶产品认证工作，其认证周期相较其他 PCB 及封装基板产品所需时间更长。

**Q8、请介绍公司封装基板业务在 FC-BGA 技术能力方面取得的进展。**

	<p>公司 FC-BGA 封装基板已具备 16 层及以下产品批量生产能力，16 层以上产品具备样品制造能力，其中 20 层产品送样认证工作亦有序推进中。</p> <p><b>Q9、请介绍公司 2024 年第四季度产能利用率情况。</b></p> <p>公司 2024 年第四季度综合产能利用率环比上季度保持平稳。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>